

厦门优迅芯片股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]2397号）。《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：<https://www.cnstock.com>；中国证券报：<https://www.cs.com.cn/>；证券日报：<http://www.zqrb.cn>；证券时报：<https://www.stcn.com>；经济参考网：<http://www.jjckb.cn>；中国日报网：<https://cn.chinadaily.com.cn>；中国金融新闻网：www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2,000万股
本次发行价格	51.66元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为1,935,733股，获配金额为99,999,966.78元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为800,000股，获配金额为41,328,000.00元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自

	发行人首次公开发行并上市之日起24个月		
是否有其他战略配售安排	是		
发行前每股收益	1.14元（按2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.86元（按2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		
发行市盈率	60.27倍		
发行市净率	2.42倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	13.03元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	21.37元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	103,320.00万元		
募集资金净额	92,768.83万元		
发行费用	本次发行费用合计10,551.17万元，具体费用明细包括： 1、承销及保荐费：保荐费840万元，承销费6,215.80万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付； 2、审计及验资费：2,100.00万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付； 3、律师费：792.45万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费：556.60万元； 5、发行手续费及其他费用：46.31万元。 注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	厦门优迅芯片股份有限公司		
联系人	杨霞	联系电话	0592-2518169
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0755-2383 5515、 0755-2383 5516

发行人：厦门优迅芯片股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025 年 12 月 12 日

（本页无正文，为《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）



2021 年 12 月 12 日

(本页无正文, 为《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页)

